

证券代码：300493

证券简称：润欣科技

上海润欣科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2024年度业绩说明会)

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者
时间	2025年05月14日 15:00-17:00
地点	公司通过“价值在线”（www.ir-online.cn）采用网络互动方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长郎晓刚先生，独立董事李艇先生，董事会秘书庞军先生，财务总监孙剑先生，保荐代表人柳志强先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">上海润欣科技股份有限公司（本文简称“公司”）于2025年5月14日（星期三）下午15:00-17:00通过“价值在线”举办2024年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络互动方式举行，业绩说明会问答环节主要内容如下：</p> <p style="text-align: center;">Q1：董事长你好！润欣科技与摩尔线程签署了合作协议，负责摩尔线程GPU的封装测试，并计划在2025年三月正式量产，请问进行的情况如何？谢谢！</p> <p style="text-align: center;">答：你好投资者，公司去年10月28日公告的新业务合作方为奇</p>

异摩尔，而非摩尔线程。双方约定的算力芯片样片交付还在履行过程中，具体项目涉及客户保密信息，谢谢你的关注！

Q2：为什么一路跌，大股东还要减持？

答：你好投资者，公司理解股东对股价波动的关切。大股东的减持计划是提前申请并严格遵守了监管规定，其减持行为是股东基于自身资金需求的正常安排，减持股份来源于公司首次公开发行前股份以及因公司实施资本公积转增股本方案而获得的转增股份。谢谢！

Q3：请问公司如何看待当前行业竞争格局？

答：你好投资者，2024年，全球半导体行业呈现复苏与结构性增长，同比增长19.1%。中国大陆在28-40nm及40nm以上成熟制程的全球产能占比持续提升，尤其是封测环节，通过模块化设计提升芯片性能与灵活性，成为国产化率最高的环节。此外，受关税和技术禁售影响，先进制程和AI、HBM芯片等，呈现“欧美研发+区域供应链割裂+亚洲制造”的行业竞争格局。预计2025年，半导体行业能够维持15%左右的销售增长。谢谢。

Q4：公司本期盈利水平如何？

答：投资者你好，报告期内，公司在AIoT智能模组、汽车电子、音频传感器等领域的业务发展稳健。2024年度公司营业收入25.96亿元，比2023年度增长20.16%；2024年度公司归属于上市公司股东的净利润3,636.98万元，比2023年度增长2.07%；2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,450.26万元，比2023年度增长10.17%；2024年度、2023年度公司经审计合并利润表中归属于上市公司股东的剔除股权激励计划实施所产生的股份支付费用影响后的净利润分别为5,081.28万元、3,225.36万元，2024年度比2023年度增长57.54%。

Q5: 管理层，贵司是否有新的市场拓展计划？

答：你好投资者，在全球半导体产业加速向地域化、AI+智能化演进的背景下，公司将以“AI驱动、数字生态共建、供应链安全”为核心战略，聚焦芯片算力升级、应用场景创新和供应链资源协同，夯实未来三至五年的可持续发展基础。公司未来发展规划：

1、积极投入“端-云协同”技术研发，打造“边缘智能体”生态。公司规划集成边缘计算芯片，采用NPU+ISP+无线基带的SOC芯片，支持客厅智能硬件、AI穿戴终端、安防摄像头等终端的本地化AI推理，组合芯片+算法+开发套件平台，聚焦数字城市、智能家居和智慧养老市场的数字化场景。

2、固守传统成熟工艺产品，平衡区域关税和汇率风险。为顺应市场变化，公司规划增加传感器芯片、分立器件、算力存储芯片等在公司业务中的占比，增加晶圆代工分销服务和模数混合芯片设计业务，整合中国大陆和台湾带有特色工艺的晶圆代工厂产能，提供包括EDA综合工具、晶圆CP测试、传感器封测、芯片定制设计在内的系列服务，保障在优势领域的无线芯片、信号调理芯片和MEMS传感器的本地供应。此外，公司规划构建“本地研发+区域性市场枢纽+友岸仓储制造”的供应链架构，平衡地缘关税与汇率风险，提升公司主营业务的核心竞争力。

谢谢你的关注！

Q6: 董事长你好！公司与子公司银行授信及减持，是经营困难还是公司有扩张计划。谢谢！

答：你好投资者，公司与子公司向银行申请综合授信额度增加，是基于公司经营发展需要，减持计划是大股东基于自身资金需求的正常安排。谢谢你对公司的关注。

Q7: 你好尊敬的董事长：一直不明白、贵司与奇异摩尔线程合作不是说三月份量产吗？咋一季报里没有摩尔线程的消息！而且股票从最高点下来已经跌了那么多请问贵司为啥还要减持！

答：你好投资者，公司去年10月28日公告的新业务合作方为奇异摩尔，而非摩尔线程。双方约定的算力芯片样片交付还在履行过程中，具体项目涉及客户保密信息。另外，公司理解股东对股价波动的关切，大股东的减持计划是提前申请并严格遵守了监管规定，其减持行为是股东基于自身资金需求的正常安排，减持股份来源于公司首次公开发行前股份以及因公司实施资本公积转增股本方案而获得的转增股份。谢谢你的关注！

Q8：公司之后的盈利有什么增长点？

答：你好投资者，公司专注于半导体集成电路产业的IC分销和IC方案设计业务，通过清晰的产品和市场定位，公司构建了稳定、高效的营销模式，在AI边缘计算、汽车电子、传感器等领域形成了差异化的竞争优势，未来公司将进一步增加区域性产业投资，平衡关税与汇率风险，拓展AI边缘计算、绿色低碳、感存算芯片等新兴技术领域。谢谢你对公司的关注。

Q9：目前研发的AI感存算一体化芯片等项目进展如何，预计何时能实现量产？

答：你好投资者，公司感存算一体化芯片（PMUT/MEMS/硅基芯片）研发及产业化项目主要应用于智能家居（微波、超声波传感）和生物医疗（成像诊断）的PMUT换能器，以及面向AI智能穿戴设备（高精度声学输出）的MEMS Speaker。目前项目处于产线（合作方）建立阶段，预计11月份完成封测和电路优化，进入市场推广阶段。谢谢。

Q10：公司在成本控制方面有哪些具体措施？

答：尊敬的投资者您好，公司在成本控制方面有以下具体措施：

1、营运成本控制：一直以来重视对于营运成本的控制以提升公司的竞争力。积极调整物流和仓储的运营模式和运输线路，在保

证交货的前提下尽可能的降低营运成本。

2、外汇汇率风险控制和融资成本控制：制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限及信息披露、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。对银行融资规模和成本进行控制，加快资金运营效率。努力实现资金使用效率最大化。

3、采购成本控制：制订了《采购管理规定》等制度，对公司的采购业务进行规范管理，以加强请购、审批、购买、验收、付款等环节的风险控制。明确采购与付款业务相关部门和岗位的职责分工、管理权限，确保不相容岗位职责相互分离、制约和监督。建立采购申请机制、供应商评估和准入机制，根据市场情况和采购计划合理选择采购供应商和采购价格，签订采购合同。采购到货后建立验收机制，货款结算时严格审核。对采购流程已实现OA系统流程化管理。

4、存货成本控制：制订了《物流部程序管理书》《VMI管理流程》等规定，明确存货管理相关部门和岗位的职责权限；建立了存货验收保管和定期盘点清查要求，规定了存货发出和领用的审批权限。物流部门定期按规定的盘点流程对所有仓库的货物进行盘点清查。制定《产品线库存控制规定》，每季度按不同的产品线周转目标和下季度预计销售额，计算设定库存最高限额，降低因过度备货而造成的资金占用风险。

Q11：你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如如何？

答：你好投资者，2024年，全球半导体行业结束周期性调整，呈现复苏与结构性增长特征。根据WSTS、中国国家统计局等的年度数据，受AI算力、存储芯片及汽车电子需求驱动，2024年全球半

导体市场规模达6276亿美元，同比增长19.1%。中国大陆集成电路年产量达到4514亿块，出口额1.14万亿元，对东盟国家出口同比增长37%。报告期内，公司在AIoT智能模组、汽车电子、音频传感器等领域的业务发展稳健，2024年度公司营业收入25.96亿元，比2023年度增长20.16%。谢谢你对公司的关注。

Q12: 目前贵司的研发项目进展情况如何?

答: 你好投资者, 公司2024年度报告的4.4主营业务分析的研发投入小节, 详细介绍了公司目前在研的研发项目及进展, 请参考, 谢谢。

Q13: 行业以后的发展前景怎样?

答: 你好投资者, 折叠的全球变革, AI技术发展与地缘政治从“长周期演进”到“加速迭代”。2024年, AI技术进一步跨越式发展, 视频生成模型Sora、阿里Wan2.1可以更精确地捕捉和模拟现实世界的动态变化; 谷歌推出Gemini系列轻量化模型, 字节跳动发布PixelDance、Seaweed等企业AI模型, 推动AI技术在视频理解、生成和交互等多样化场景中的深度渗透。12月, 中国的AI新锐DeepSeek通过开源模型DeepSeek-V3和推理模型R1, 以低训练成本实现与OpenAI相当的性能, 显著降低AI开发门槛, 成为全球AGI技术竞争的关键变量。DeepSeek的开源模式促使云边端协同支持Transformer架构, 将AI+与边缘计算深度融合, 通过分布式架构实现各类终端设备的智能进化。2024年, 全球AI产业规模达到6382亿美元, 据Statista预测, 至2030年各类AI+智能终端替代数十亿台, 整体市场规模将达到1.8万亿美元。供参考, 谢谢。

Q14: 公司“定制和自研芯片”业务销售额增长明显。公司在定制和自研芯片业务上的技术优势是什么?

答: 你好投资者, 公司“定制和自研芯片”采用了JDM(合作开发制)模式。该业务具有以下几个差异化优势:

- 1、客户参与式制造：从产品需求定义到交付和客户全程协同。
- 2、国产替代和自主可控：成本优势。
- 3、韧性布局：可以通过（产线、芯片、配件选择）贴近市场，有效规避关税的风险。

Q15：24年营收增长但扣非净利润下降的原因？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关心与关注。

2024年度公司营业收入259,586.97万元，比2023年度增长20.16%；2024年度公司归属于母公司股东的净利润3,636.98万元，比2023年度增长2.07%；扣除非经常性损益后的净利润为3,450.26万元，比2023年度增长10.17%。

2024年公司归属于母公司股东的净利润增长幅度小于营业收入增长幅度的主要原因为：2024年度公司实施2024年限制性股票激励计划，于2024年8月完成首次授予工作。2024年公司以权益结算的股份支付等待期内确认的费用金额1,444.30万元，2024年度经审计合并利润表中归属于上市公司股东的剔除上述股份支付费用影响后的净利润5,081.28万元，比2023年度增长57.54%。

Q16：请说明汽车电子业务的具体增速，以及是否主要依赖功率半导体量增。

答：汽车电子业务增速主要来自于大陆新能源汽车渗透率提升，ADAS智能化需求增长及功率半导体增速明显。汽车电子业务受中美贸易冲突的影响相对较小。谢谢。

Q17：美国实体清单导致产品集成业务营收损失，通过国产替代是否抵消30%的冲击？

答：本公司芯片和解决方案分销业务未受到美国实体清单的禁售影响，相关企业应通过供应链多元化，技术自主等措施抵消冲击带来的影响。

Q18: 贵司未来3-5年的发展规划如何?

答: 你好投资者, 在全球半导体产业加速向地域化、AI+智能化演进的背景下, 公司将以“AI驱动、数字生态共建、供应链安全”为核心战略, 聚焦芯片算力升级、应用场景创新和供应链资源协同, 夯实未来三至五年的可持续发展基础。公司未来发展规划:

1、积极投入“端-云协同”技术研发, 打造“边缘智能体”生态。公司规划集成边缘计算芯片, 采用NPU+ISP+无线基带的SOC芯片, 支持客厅智能硬件、AI穿戴终端、安防摄像头等终端的本地化AI推理, 组合芯片+算法+开发套件平台, 聚焦数字城市、智能家居和智慧养老市场的数字化场景。

2、固守传统成熟工艺产品, 平衡区域关税和汇率风险。为顺应市场变化, 公司规划增加传感器芯片、分立器件、算力存储芯片等在公司业务中的占比, 增加晶圆代工分销服务和模数混合芯片设计业务, 整合中国大陆和台湾带有特色工艺的晶圆代工厂产能, 提供包括EDA综合工具、晶圆CP测试、传感器封测、芯片定制设计在内的系列服务, 保障在优势领域的无线芯片、信号调理芯片和MEMS传感器的本地供应。此外, 公司规划构建“本地研发+区域性市场枢纽+友岸仓储制造”的供应链架构, 平衡地缘关税与汇率风险, 提升公司主营业务的核心竞争力。

润欣科技的核心优势是专注、专业化, 公司有信心在未来继续维持良性的增长, 公司将秉承“专注、专业化、差异化”的理念, 为客户创造价值, 为员工提供稳定开放的工作环境, 为股东和社会创造效益。

谢谢你的关注!

Q19: 请问贵司是否有权自行选择通过启动现金及发行股份购买资产流程等方式增持奇异摩尔的股权至不超过20%。什么时候执行?

答: 你好投资者, 你提问的关于公司对合作公司购股权的行

	使，目前未到协议约定的时点。谢谢。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单 (如有)	无
日期	2025年05月14日